



社長メッセージ

モバイル機器を中心に拡大する半導体需要を取り込むと同時に、事業環境の変化に柔軟な対応ができる組織づくりに注力していきます。



CUTTING EDGE

カッティングエッジ



DISCO

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies

75期中間事業のご報告

2013年4月1日～2013年9月30日

事業環境・業績

2013年度上期には、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器市場の拡大を背景に、半導体・電子部品メーカー各社による設備投資が積極的に実施されました。このような中、当社の精密加工装置は量産拠点が集中するアジア地域向けに出荷が好調だったほか、精密加工ツールでも販売数量が堅調に推移したため、グループ全体の売上高は半期としては過去最高となる546億円になりました。

損益面では研究開発費を中心に販売管理費が増加しましたが、円高是正や製品構成の変化などにより粗利率が大幅に改善したことから、営業利益は前年同期に対し大きく増加しました。また、純利益は半期としては過去最高を更新し、中間配当は前年同期から10円増配となる1株当たり50円とさせていただきます。

※OSAT：Outsourced Semiconductor Assembly and Testの略。サブコンと同義で半導体組立検査受託会社を指す。

※IDM：Integrated Device Manufacturerの略。自社内で回路設計から製造工場、販売までの全ての設備を持つ垂直統合型のデバイスメーカーを指す。

見通しと取り組み

アジア地域のOSAT*が行ったモバイル機器の量産向け設備投資は上期で一巡しましたが、下期には欧米地域のIDM*などから新たな引き合いが増加すると見込んでおります。下期売上高は上期比13%減となる475億円を想定しますが、例年に比べ小幅な減少に留まっております。これらの業況を踏まえ、通期売上高は過去最高となる1,021億円を予想しております。

当社では近年の売上規模拡大に伴い、いわゆる大企業病と呼ばれる企業リスクに対処する必要が出てきたと考えております。例えば、業務を行う上で前例や形式にとらわれ杓子定期的な対応となってしまう、トラブル発生時に全てをルール化し業務スピードが落ちてしまう、などといった弊害です。このような組織の硬直化を防ぐために、社員の行動変化を促すさまざまな施策を実施していき、お客さまからの急な量的要望などに応えられる柔軟な組織づくりに注力してまいります。

株主の皆様におかれましては今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

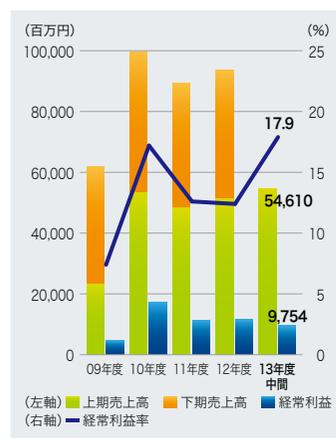
2013年12月

代表取締役社長 関家一馬



財務ハイライト

売上高・経常利益・経常利益率



当期純利益・1株当たり当期純利益



総資産・自己資本比率



キャッシュ・フロー



当期の概況

当期(2013年4月1日から2013年9月30日まで)では、当社製品の出荷は堅調に推移し、半期としては過去最高の売上高となりました。

製品別では、精密加工装置の売上高は前年同期と比べ減少したものの、モバイル機器の需要拡大を背景に、電子部品向けの売上高は精密切断装置(ダイサ)・精密研削装置(グラインダ)共に増加しました。消耗品である精密加工ツールは、円高是正に加えて、出荷数量が半導体メーカの設備稼働率に比例して堅調に推移したため、半期の売上高としては過去最高を更新しました。

利益については、人件費や研究開発費などの販売管理費が前年同期と比べ増加しましたが、円高是正や製品構成の変化などによりGP率が上昇したことから営業利益は大きく増加しました。また、法人税率の低下などにより半期としては過去最高の純利益となりました。

以上の結果、当期の業績は売上高546億10百万円(前年同期比6.3%増)、営業利益98億6百万円(同30.8%増)、経常利益97億54百万円(同24.8%増)、四半期純利益66億63百万円(同24.4%増)となりました。

■財政状態について

当期末の総資産は、前期末と比べ98億93百万円増加して1,655億60百万円となりました。これは、売上高の増加による売上債権の増加や、桑畑工場新棟の建設に伴う建設仮勘定の増加などによるものです。負債は、前期末と比べ23億55百万円増加して474億66百万円となりました。これは、主に仕入債務が増加したことによるものです。純資産は、前期末から75億37百万円増加し1,180億93百万円と

なり、自己資本比率は前期末比0.3ポイント増の70.1%となりました。

■キャッシュ・フローの状況

営業活動では90億44百万円の資金増加、投資活動では62億81百万円の資金減少だったことから、フリー・キャッシュ・フローは27億63百万円の資金増加となりました。これは、営業活動による資金増加が前年同期と比べ大きく減少したことや投資活動において桑畑工場新棟の建設など有形固定資産の取得に係わる資金支出があったため、フリー・キャッシュ・フローは前年同期と比べ大きく減少しました。

財務活動では主に配当の支払いを行っております。これらの結果、当期末の資金残高は前期末から21億27百万円増加し、236億71百万円となりました。

通期の連結業績予想

スマートフォンやタブレット端末の量産向け設備投資は上期で一巡しましたが、一方で欧米地域での新たな引き合いが増加しています。そのため、下期の売上高は従来予想を上回る見通しとなりました。また、配当については業績予想に連動して見直した結果、1株当たり期末配当は32円(中間50円とあわせ年間82円は過去最高)を予想しております。

2013年度

(金額の単位：百万円)

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
102,100	15,400	15,700	10,900	322.62円

CLOSE UP! 1 ディスコの成長戦略

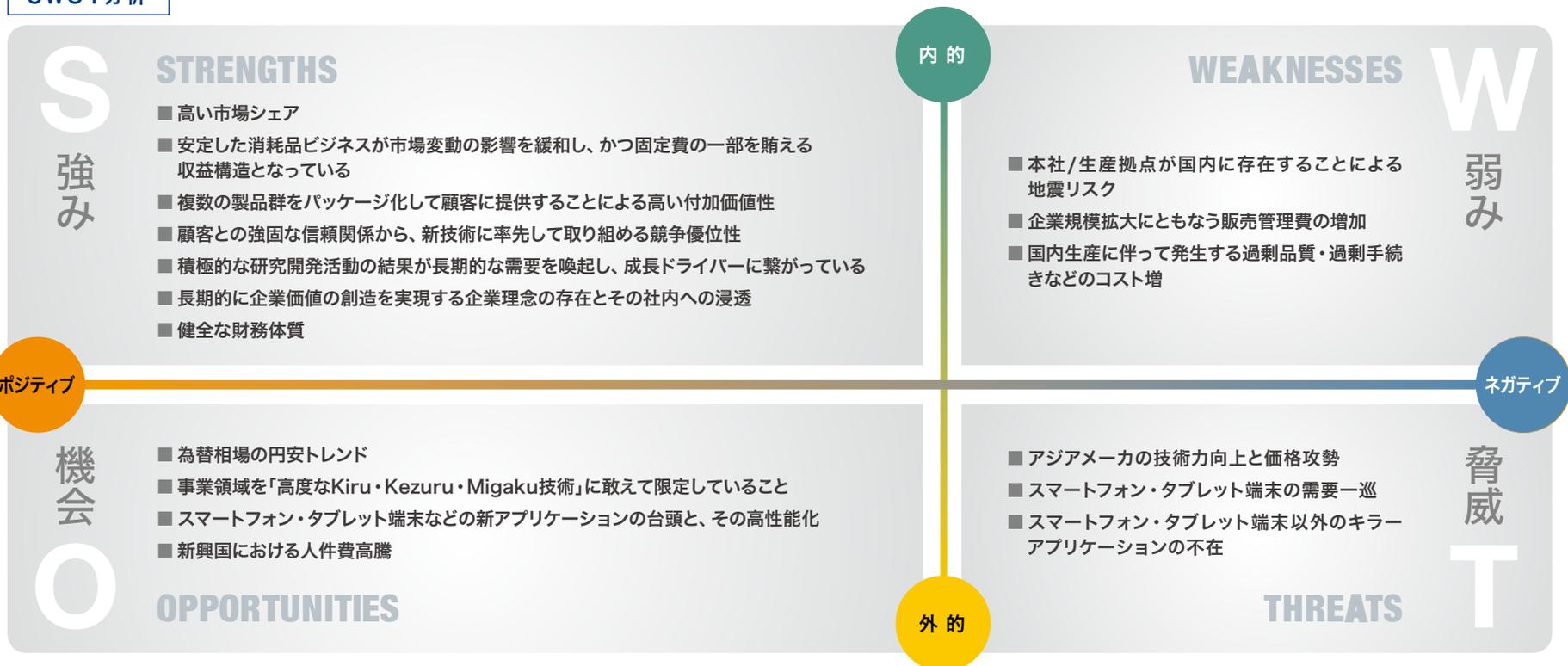
自社分析

事業環境の変化に柔軟に对应していくため、自社の特徴を改めて分析します。

昨今の半導体業界では、製造プロセスの分業化などの業界構造の変化や、スマートフォンをはじめとするアジアメーカの台頭などが発生し、その事業環境は刻々と変化しています。このような変化に柔軟に対応し、当社が持続的な競争優位性を実現していくためには、的確な戦略計画を設計する必要があります。

そこで、SWOT分析を通じて、自社の『強み』『弱み』『機会』『脅威』についてそれぞれ内部分析を行うこととします。これらをもとに中期的な経営方針として、『強み』『機会』については一層の伸長を図り、『弱み』『機会』については、具体的な施策を検討・実施していき、盤石な体制を整えてまいります。

SWOT分析



自社分析から事業戦略へ

CLOSE UP! 1 ディスコの成長戦略

事業戦略

自社分析に基づいた事業戦略を進め、持続的な競争優位を実現していきます。

近年の消費者の購入傾向は、従来型のPCからより低価格のスマートフォンやタブレット端末に移行しています。これは『高単価・高品質』な市場トレンドが、『リーズナブルな価格・早い商品化スピード』という市場に置き換わりつつあることを意味します。

この流れに合わせ、半導体業界では製造メーカ各社が製造コストを抑え、開発サイクルを早めるために、アジア地域の加工受託メーカへ半導体部品の量産を依頼する構造に変遷し

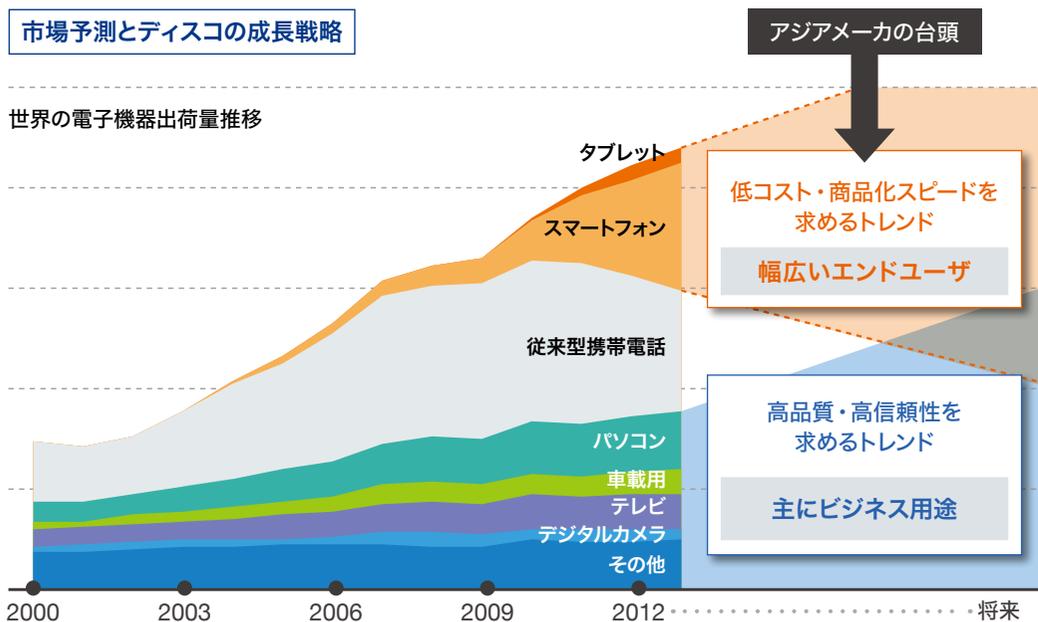
ています。このため、当社の精密加工装置の引き合いは従来のハイスペック機に加え、ローエンド機でも増加傾向にあり、その一部では厳しい価格競争に晒されています。これに対し、競合するアジアメーカにおいて人件費がいずれ増大し、生産コストが上昇する局面を迎えるまでの間、当社は数々の施策を実施し、この難局を乗り切っていくと考えています。

具体例として、一番力を入れて取り組んでいることは、この市況の変化に対応できるスピードをもつ組織力の醸成です。

そして、生産拠点を国内に構えることで発生する『過剰品質』や『過剰手続き』などの余剰な経費を削減し、可能な限り生産コストを低減させます。また、新技術・新領域での付加価値の高いビジネスモデルを構築・増長させ、アプリケーション技術の多角化を進めます。

これらの取り組みにより、中期的なリスクを排除し、持続的な競争優位性を実現していきます。

市場予測とディスコの成長戦略



経済成長に伴い、アジアメーカもいずれはコストが上昇...

ディスコの競争優位への挑戦

- 進化スピード、対応スピードの向上
- 日本で出来るかぎりのコストダウン
- 価格勝負ではないハイエンド領域での利益追求
- 製品の付加価値を重視する顧客とのビジネス展開
- 過去からのノウハウの蓄積

持続的な競争優位を実現

CLOSE UP! 2 成長するDISCOの技術

これまで以上により高品位に、より速く加工する。

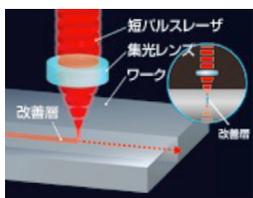
近年、レーザ加工技術はレーシック(視力矯正手術)やレーザ脱毛、レーザポインタなど、多くの分野で利用され、私たちの生活に役立っています。このレーザ技術を応用し、高度な切削加工を実現するディスコのレーザソーは、2002年より販売を開始し、

そのアプリケーションに広がりを見せています。特にスマートフォンやタブレット端末などの最終製品が高機能化するに従い、搭載される半導体チップはこれまで以上に『薄く、硬く、脆く』なる傾向にあり、これらをより高品位に、より速く加工したいというニ-

ーズが増えてきています。このページでは新たな事業の柱になりつつあるレーザソーの製品ラインナップを時系列で振り返り、先端技術に対するディスコの取り組みを紹介します。

ステルスダイシング

レーザを被加工物の内部に集光させ、改質層と呼ばれる脆弱な層を形成し、そこを起点に力を加えてチップの分割をおこなうダイシング方法です。分割された加工面は綺麗で、さらに加工屑が発生しないため洗浄工程が不要となります。高輝度LEDやMEMS※1などの加工に適しています。



ステルスダイシング 加工点 概略図

浜松ホトニクス社と提携し開発したフルオートマチックレーザソー「DFL7340」(200mm対応) / 「DFL7360」(300mm対応)。初のステルスダイシング技術を採用し、TVやPCのバックライトなどに用いられる高輝度LEDの分割を実現します。LEDの性能を損なわずに加工することが可能なため、高付加価値デバイスに適しています。



DFL7360 外観図

DFL7340 外観図

「DFL7360」にリングフレーム搬送機構を追加したフルオートマチックレーザソー「DFL7360FH」。ウェーハサイズの大口径化に伴い、その加工用途が増加する傾向にあることから、汎用性を高めました。



DFL7360FH 外観図

多様なプロセスに一台で柔軟に対応できるフルオートマチックレーザソー「DFL7361」。最先端の技術プロセスや量産現場にて求められる複数の加工方法にすばやく対応できる性能を有しています。



DFL7361(開発機) 外観図

2002

2007

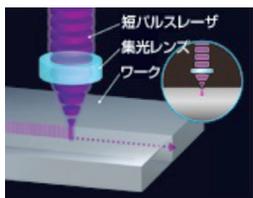
2009

2011

2013

アブレーションダイシング

被加工物の表面に極短時間レーザエネルギーを集中させ、固体を瞬間的に昇華・蒸発させる加工方法です。非接触での加工を可能とすることから、砥石では困難だった脆い素材や粘性の高い素材のダイシングなどに適しています。近年では微細化が進む半導体に必要なLow-K膜※2やDAF※3テープ向けに出荷が伸びています。



アブレーション加工 加工点 概略図

加工用途を限定せず、市場ニーズを開拓する目的で販売されたレーザソーの原点、フルオートマチックレーザソー「DFL7160」。



DFL7160 外観図

生産効率を高めるために2つのレーザ発振器を搭載可能としたフルオートマチックレーザソー「DFL7260」。



DFL7260 外観図

「DFL7160」の後継機となるフルオートマチックレーザソー「DFL7161」。生産性や信頼性、操作性といった装置の基本性能を大幅に向上させました。



DFL7161 外観図

本装置はSEMICON Japan 2013(12/4-6:幕張メッセ)に出展いたしました。

SEMICON Japan 2012 当社ブースの様子



※1 MEMS: Micro Electro Mechanical Systemsの略。微細な技術によって作られ、電氣的に駆動される小さな機械
 ※2 Low-K膜: チップの微細化に伴い、半導体の回路配線がより隣接するようになると配線間信号干渉が発生するため、これを回避する為に使用される材料。空洞を多く含むためダイシングソーで切断しようとすると品質が保てない
 ※3 DAF: Die Attach Filmの略。チップを実装・積層するのに用いる特殊粘着フィルム



ディスコの企業理念



「高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評定されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができてきているか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。